

广州三孚新材料科技股份有限公司
投资者关系活动记录表（7月12日）

编号：2026-003

投资者关系 活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☒其他：线上投资者交流会
会议时间、 参与单位名称及人员姓名	2026年7月12日 20:00-21:00 安信基金；百年保险；宝盈基金；博时基金；渤海证券；昌迪资产；财通基金；财通证券；诚泰财产；晟盟资产；崇山股权投资；稻沣投资；东北证券；东方基金；东方证券；东吴证券；赋格投资；方正证券；风炎私募；复胜资产；富国基金；富唐航信；富中集团；Grand Alliance Asset Management；高毅资产；高竹私募；亘曦私募；耕霖投资；古曲私募；冠达菁华；光大证券；广发基金；广发证券；国花资产；国华兴益保险；国金证券；国联安基金；国联民生证券；国盛证券；国泰海通；国泰基金；国泰君安；观想科技；国信证券；昊晟投资；和谐汇一；和谐健康保险；恒泰证券；珩道投资；红骅投资；红钧资本；宏道投资；泓德基金；泓毅投资；华安证券；华宝基金；华创证券；华发证券；华福证券；华龙证券；华泰证券；华西基金；华西证券；华夏久盈；华源证券；汇丰晋信基金；季胜投资；嘉鸿私募；嘉实基金；嘉信私募；建信养老金；江苏微导纳米；江阴米利都私募；金百镭投资；金鹰基金；聚隆投资；聚鸣投资；开源证券；凯丰投资；利得基金；利幄私募基金；粒子跃动；民生证券；名禹资产；宁远资本；暖逸欣私募；平高集团；浦东银行；POLO ELITE；前海聚龙；前海利信；前海人寿；钦沐资产；勤辰私募；秋收私募；瑞天基金；瑞银证券；润洲私募；上海德汇集团；上海雷钧私募；上海熵盈基金；上海添益私募；上海证券；上海佐坤私募；上汽金控；上银基金；申万菱信；申银万国证券；天风证券；天芸资本；彤源投资；万和

	证券；万家基金；望道中观；伟星资管；西部证券；西南证券；橡果资产；晓喆私募；新华基金；新华新媒文化；新华资产；鑫融长弘；信金万邦；星熹元私募；兴银理财；宜信融资产；以太星辰资产；易方达基金；胤胜资产；永安国富；永赢基金；友邦保险；圆信永丰基金；越秀集团；粤开证券；鑒义投资；长城财富保险；长城基金；长盛基金；长信基金；浙江百盈私募；浙商证券；真科基金；真滢投资；正圆私募；证国私募；智合远见；中邦投资；中国平安；中国铁建；中航证券；中金公司；中泰证券；中信建投；中银基金；中邮创业基金；中邮证券；中哲物产；尊和资产等 195 名机构及个人投资者。
地点	电话会议/腾讯会议
上市公司接待人员姓名	董事、董事会秘书：刘华民
投资者关系活动主要内容介绍	公司于 2026 年 7 月 12 日召开了线上交流会，由董事、董事会秘书刘华民对公司高端电子铜箔业务布局进行了介绍。之后，刘华民先生与参会人员进行了问答交流，交流的主要内容包括： 提问 1、新设合资公司的其他股东方主要具有什么背景？ 答：您好！合资公司的其他股东方在微纳电子、铜箔及 PCB 产业链拥有深厚的技术积淀与丰富的产业化管理经验，通过引入产业方股东，各方将合力构建覆盖“研发-验证-量产-应用”闭环生态，加速高端电子铜箔技术的验证迭代与规模化落地，提升高端电子铜箔产业化推进效率。 提问 2、公司认为目前高端电子铜箔产业主要瓶颈和竞争在哪里？ 答：您好！当前高端电子铜箔产业的主要瓶颈不仅体现在产品工艺的突破，也包括后处理设备和配套化学品系统性供应能力不足，且这一领域市场仍主要由少数海外企业主导。与此同时，终端客户对高端电子铜箔的性能与供应稳定性更为重视，价格敏感度相对较低，因此，在供给偏紧的市场环境下，产业竞争的核心在于谁能率先实现规模化量产并保障稳定交付。 提问 3、贵司的高端电子铜箔生产工艺和其他厂商的区别？

答：您好！高端电子铜箔如 HVLP4、HVLP5 等，对表面粗糙度、电镀均匀性及信号损耗控制等关键技术指标的要求极为严苛，对工艺精度和一致性要求较高。公司的核心工艺聚焦于电解铜箔的后段精密加工环节，生产工艺主要为：电解铜箔（外采）→减铜→精细电镀→化学后处理（公司提供电解铜箔生产环节后所需的设备及配套专用化学品）。在此过程中，公司采用小直径阴极辊，配合小电流、小电压的精细化控制，并搭配公司自主研发的电镀添加剂，实现纳米级沉积，使铜箔表面的粗糙度得到精细控制，满足 HVLP4 以上级别铜箔的严苛要求。与传统四代铜箔工艺相比，公司的核心优势主要体现在更高的良率。

提问 4、是否有给下游送样，验证周期如何？

答：您好！公司目前正在与多家产业客户进行沟通，并积极推进送样及验证相关工作。具体验证周期受客户内部测试流程、应用场景要求等因素影响，暂无法统一预估。后续如有实质性进展，公司将严格按照信息披露要求，及时向市场传递相关进展。

提问 5、公司 PCB 设备业务当前的新签订单情况如何？公司当前交付能力如何？

答：您好！公司 PCB 设备业务目前在手订单充足，主要涵盖 VCP 填孔电镀线、RTR 卷对卷电镀线等，硬板电镀线还包括价值较高的 40：1 高纵横比厚板和高精细线路电镀设备。受益于下游客户正处于扩产初期，设备需求释放明确，一季度订单超过 2 亿元。在交付能力方面，当前具备每月约 8 台设备的稳定交付能力，能够有效保障订单的按期履约。

提问 6、公司玻璃基板通孔金属化和填孔设备后续发展趋势如何？

答：您好！我们认为随着玻璃基板在先进封装领域的应用逐步明朗，预计 2027 至 2028 年将迎来规模化量产的关键窗口期。公司早在产业发展初期即已前瞻布局，优先选择技术水平领先、终端客户覆盖海外头部企业的合作伙伴进行深度协作，持续通过打样验证优化电镀设备及配套专用化学品性能。与此同时，近期亦有其他客户向公司提供玻璃样品进行打样测试，并已就电镀设

	备采购及药水研发配套等事项启动商务洽谈。 更多往期调研情况及重复性问题，可查阅公司于上证 E 互动平台“上市公司发布”栏目刊载的各期《广州三孚新材料科技股份有限公司投资者关系活动记录表》。
附件清单	无